**News Release**

No.: REN0803(A)

**Renesas Electronics Permette di Accelerare lo Sviluppo di Progetti di Gateway per Reti di Sensori grazie alla Soluzione RZ/N1S IO-Link Master per lo Smart Factory**

*Una Soluzione Single-Chip ed un Kit di Sviluppo di Semplice Utilizzo Accelera lo Sviluppo delle Applicazioni Basate su IO-Link per Industry 4.0*

**Düsseldorf, 26 Novembre 2018 –** Renesas Electronics Europe (TSE: 6723), uno dei principali fornitori di soluzioni avanzate basate su dispositive a semiconduttori, presenta oggi un nuovo kit di sviluppo per IO-Link master nato per accelerare lo sviluppo delle applicazioni basate su IO-Link per le reti industriali da utilizzare nel campo dello Smart Factory.

La soluzione per IO-Link master basata su RZ/N1 consente di ridurre la lista dei componenti (BOM), il suo costo e di ridurre anche le dimensioni del sistema finale. La soluzione si basa su un singolo chip che contiene due CPU in grado di operare in modo indipendente e contemporaneamente accoppiate ad una RAM statica di generose dimensioni. Il master IO-Link a otto porte viene controllata da una delle CPU mentre l’altra (R-IN Engine) si occupa di gestire i protocolli Ethernet industriali fino al livello più alto, come ad esempio il caso dei PLC, senza la necessità di utilizzare microcontrollori esterni, microprocessori, FPGA o memorie quali ad esempio le DDR. Grazie all’ integrazione di due CPU all’interno di un package estremamente compatto (12mm x 12mm LFBGA) RZ/N1 facilita lo sviluppo di progetti che richiedono dimensioni e footprint sul circuito stampato ridotti. Rispetto a soluzioni basate su FPGA o su processori ad alte prestazioni non così integrati, RZ/N1 presenta anche consumi molto più ridotti, questo consente una notevole riduzione nei costi dello stadio di alimentazione, una ulteriore riduzione delle dimensioni del sistema e consente di ridurre i problemi derivanti dalle alte temperature grazie ai minori livelli di dissipazione.

Il kit di sviluppo è composto da una scheda elettronica ed un pacchetto software qualificato fornito dal nostro partner TMG. La scheda include otto connettori IO-Link che consentono ai progettisti di collegare immediatamente i dispositivi IO-Link slave e di iniziare in brevissimo tempo il processo di valutazione. Il kit di sviluppo, grazie alla semplicità di utilizzo, consente sia di ridurre il tempo normalmente necessario tra la fase di prototipazione e quella di produzione sia di ridurre il carico di lavoro ed i rischi per i progettisti coinvolti nello sviluppo di questi complessi progetti.

**Le principali caratteristiche della soluzione RZ/N1S IO-Link Master**

La robustezza dell’ambiente di sviluppo consente di ridurre in modo considerevole la fase di valutazione del sistema.

* Il kit di sviluppo All In One consente ai progettisti di semplificare la fase di valutazione che può essere immediata e può accelerare il Time to Market.
* La scheda di sviluppo, grazie alle sue otto porte IO-Link, consente di ottenere una prototipazione rapida e di connettersi a qualsiasi periferico IO-Link.
* Il software qualificato fornito dal nostro partner [TMG TE](https://www.tmgte.de/en/) consente di ridurre in modo significativo il tempo richiesto per passare dalla fase di prototipazione alla fase di produzione.

Progetto ottimizzato per ambienti industriali che richiedono dimensioni limitate.

* La disponibilità, on chip, di 6 MB di SRAM elimina la necessità di memoria esterna in molte applicazioni.
* Il package (12 mm x 12 mm LFBGA) rende RZ/N1 la soluzione ideale per tutte le applicazioni in cui la dimensione del circuito stampato è importante per aderire alle richieste di sistemi di dimensioni ridotte.
* Il consumo di RZ/N1 è estremamente ridotto, quando comparato con sistemi basati su FPGA o su processori non così dedicati alle applicazioni embedded. Questo consente di ridurre ulteriormente la richiesta di spazio su scheda occupato dalla sezione di alimentazione e dei costi del sistema finale.

“Come leader nella fornitura di soluzioni IO-Link, TMG ha supportato i progettisti dei sistemi IO-Link dal momento in cui questa tecnologia è stata rilasciata. Le ridotte dimensioni, lee due CPU integrate, una dedicata alla gestione della rete IO-Link e l’altra dedicata alla gestione dei protocolli Ethernet industriali, rendono RZ/N1S la scelta migliore per le tipiche applicazioni IO-Link master. Siamo ansiosi di supportare i progettisti che utilizzano RZ/N1S con le nostre soluzioni basate sugli stack IO-Link, PROFINET e EtherNet/IP”, afferma Klaus-Peter Willems, Managing Partner of TMG.

“Renesas ha fornito una ampia gamma di soluzioni dedicate alle applicazioni dell’automazione industriale per più di 25 anni. Questo supporto continua ad espandersi allo scopo di supportare la recente richiesta di prodotti in grado di gestire lo sviluppo di applicazioni Industry 4.0”, afferma Akira Denda, Vice President of Industrial Automation Business Unit, Renesas Electronics Corporation. “Questa nuova soluzione per IO-Link master, supportata dal nostro partner TMG, aiuterà i progettisti a portare sul mercato soluzioni innovative in modo più semplice ed in modo più rapido e, in ultima analisi, potrebbe consentire una espansione dell’utilizzo delle reti IO-Link nelle applicazioni Smart Factory.”

Renesas dimostrerà la nuova soluzione master IO-Link al booth 130, Hall 10.1, all’esibizione [SPS IPC Drives](https://www.mesago.de/en/SPS/), dal 27 al 29 di Novembre 2018 a Norimberga, in Germania.

Per avere ulteriori informazioni a proposito della soluzione IO-Link vi preghiamo di visitare la seguente pagina Web: <https://www.renesas.com/us/en/products/software-tools/boards-and-kits/eval-demo/io-link-master-development-kit.html>

Per ottenere maggiori informazioni sulle caratteristiche della rete industrial IO-Link potete visitare il seguente link: <http://www.io-link.com>.

**Disponibilità:**

La soluzione RZ/N1S IO-Link master è già disponibile su richiesta. Potete contattare i nostri distributori, in ordine alfabetico, Arrow, Avnet, Rutronik oppure contattare direttamente il nostro ufficio di Milano:

Indirizzo: Viale Vincenzo Lancetti 43 - 20147 Milano (MI)

Telefono: +39 02 48714892

**A proposito di Renesas Electronics Corporation**

Renesas Electronics Corporation ([TSE: 6723](https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.jpx.co.jp_english_&d=DwMFAg&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=mWLUx0QVt25BWK-MZ29zLPLQHyv8UpUkXzcgXaA3aWQ&m=DYdTH9hu-7LaulV1SVM6YKpZz_t6AqnyxumFHk-LqFg&s=UlMPBZIH1yicvEPu6e6QHB45plYIXPqV-0XV5KGZZl0&e=)) distribuisce innovazione nel mercato embedded per mezzo di soluzioni complete a semiconduttori che permettono a miliardi di dispositivi intelligenti connessi di migliorare il modo in cui le persone vivono e lavorano – in modo sicuro. Fornitore [globale](https://www.renesas.com/about/company/profile/global.html) numero uno di microcontrollori e leader nei prodotti A&P, SoC e piattaforme integrate, Renesas fornisce l’esperienza, la qualità e una serie di soluzioni complete per una vasta gamma di applicazioni Automotive, Industriali, Home Electronics (HE), Office Automation (OA) and Information Communication Technology (ICT) per contribuire a plasmare un futuro senza limiti. Ulteriori informazioni circa Renesas sono disponibili visitando [renesas.com](https://www.renesas.com/en-eu/).

###

(Remarks) All other names of products or services mentioned in this press release are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

**Per informazioni e richieste:**

Simone Kremser-Czoer

Renesas Electronics Europe GmbH, Karl-Hammerschmidt-Str. 42, 85609 Aschheim-Dornach   
Tel.: +49 89 38070-216  
Email: simone.kremser-czoer@renesas.com  
Web: [www.renesas.com](http://www.renesas.com)

**Contatto in agenzia per ulteriori informazioni:**

Alexandra Janetzko / Martin Stummer

HBI Helga Bailey GmbH (PR agency), Stefan-George-Ring 2, 81929 Munich, Germany

Tel.: +49 89 99 38 87-32 / -34

Fax: +49 89 930 24 45

Email: [alexandra\_janetzko@hbi.de](mailto:alexandra_janetzko@hbi.de) / [martin\_stummer@hbi.de](mailto:martin_stummer@hbi.de)

Web: [www.hbi.de](http://www.hbi.de/)